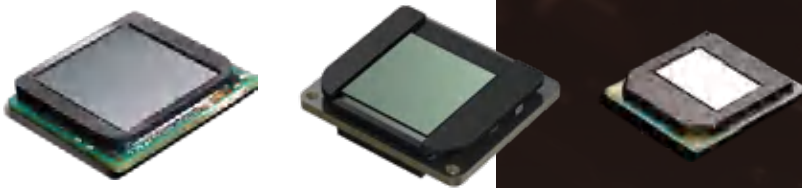


晶圆级封装非制冷 红外探测器

■ 专为新兴市场和
红外应用普及而生



产品介绍：

晶圆级封装（WLP）是直接在晶圆片上完成高真空封装测试程序之后，再进行划片切割制成单个红外探测器的工艺流程。红外技术应用于消费电子市场主要需要解决的问题就是微型化和低成本，晶圆级封装恰好能满足这一需求。高芯科技的晶圆级封装红外探测器已实现量产，多种成熟稳定的晶圆级红外机芯方案将开启红外技术在多个领域的新兴应用。

满足微型化和轻量化需求

- 超小体积
- 超低重量
- 无TEC

探测灵敏，成像清晰

- 高灵敏度，全系典型NETD小于40mK
- 成像优质，画质流畅，帧频可达50Hz

低成本实现红外功能集成

- 产量更高，成本更低



产品参数表

产品型号	GST612W	GST417W	GST212W
敏感材料	氧化钒		
阵列规格	640×512	400×300	256×192
像元间距	12μm	17μm	12μm
光谱范围	8-14μm		
典型NETD	<40mK		
输出信号	内置14位ADC		
热响应时间	<12ms		
最大帧频	50Hz	50Hz	30Hz
功耗	≤220mW	≤180mW	≤75mW
尺寸(mm)	18×16×2.75 (不含接口)	18×16×2.75 (不含接口)	10.53×7.44×1.45 (不含PCB)
重量	<2g	<2g	<0.5g
工作温度	-40℃ ~ +85℃		

规格如有变更，恕不另行通知

武汉高芯科技有限公司

☎ 400-027-0198

✉ marketing@gst-ir.com

🌐 www.gst-ir.com

📍 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号,430205

